

低伝送損失接着フィルム

AS-400HS/MCF-400HS

■特長

- 良好な誘電特性(低伝送損失)を示します。
- 多層化成形可能です。
- PTFEと優れた接着性を有します。
- レーザIVHでの接続が可能です。

■用途

- アンテナ用
- 高速通信基板

■一般仕様

品番	タイプ名	標準絶縁層厚さ	標準キャリアフィルム
AS-400HS	—	25 μ m,50 μ m,65 μ m	50 μ m(材質PET)
MCF-400HS	—	25 μ m,50 μ m,65 μ m	12 μ m,18 μ m(HVLP銅箔)

■一般特性

●Cステージ特性

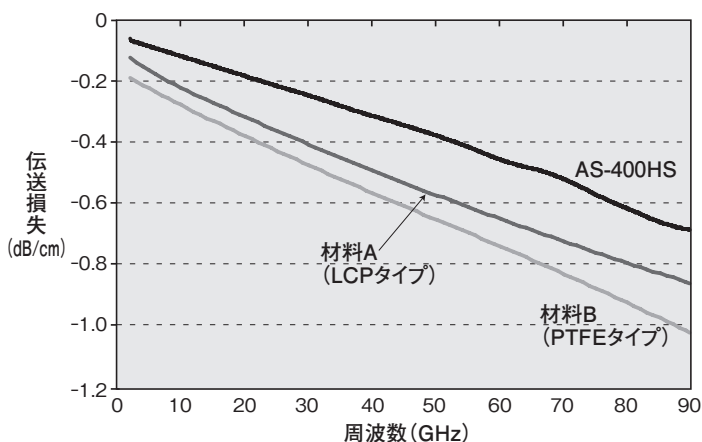
試験項目	処理条件 *3	単位	実測値	参考規格 (IPC-TM-650)
			AS-400HS/MCF-400HS	
貯蔵弾性率 (DMA法:25°C)	A	GPa	3~5	—
ガラス転移温度 Tg (DMA法)	A	°C	190~250	—
熱膨張係数 *1	Z	ppm/°C	(<Tg)	2.4.24
			(>Tg)	
はんだ耐熱性 (260°C)	A	秒	>300	—
銅箔引きはがし強さ	18 μ m HVLP	A	kN/m	0.45~0.60
比誘電率	10GHz *2	A	—	2.9~3.1
誘電正接	10GHz *2	A	—	0.0020~0.0030

注1) 昇温速度:10°C/min.(圧縮法) 注2) 空洞共振法によります。 注3) 最終ページの「処理条件の読み方」参照

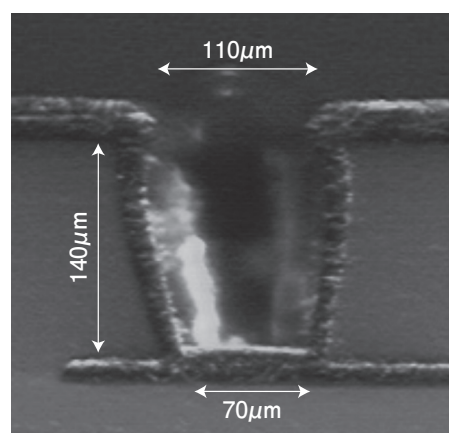
●Bステージ特性

試験項目	処理条件	単位	実測値	参考規格
揮発分	180°C 5分重量法	wt%	2以下	—

●伝送損失測定結果

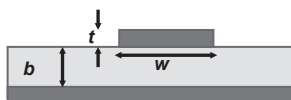


●レーザービア断面



《測定条件》

- 評価基板: マイクロストリップライン
- 温度及び湿度: 25°C/40%RH
- 特性インピーダンス: 50 Ω
- 構成方法: TRL



- 導体幅 (w): 240~270 μ m
- 絶縁層厚み (b): 100~130 μ m
- 導体厚み (t): 30 μ m(めっき銅含む)